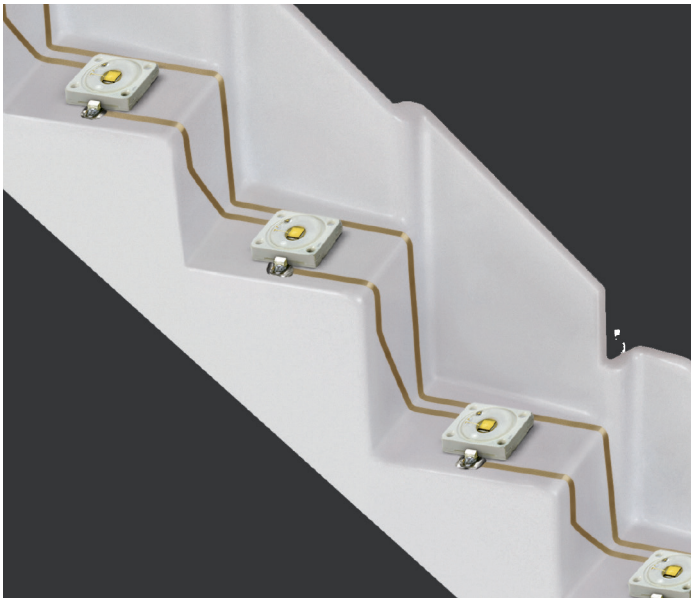
MID 选择性金属化

模塑互连装置的解决方案

模塑互连器件（MID）正在迅速扩展到电子应用的新兴领域。曾经是移动设备的支柱，现在医疗、汽车和照明行业的机会越来越多。随着这些机会的增加，正在考虑采用新材料来解决与应用相关的物理特性和成本。

MacDermid Enthone MID化学度溶液经过专门设计和优化，可为激光直接结构化、催化剂油墨和双射模塑互连器件提供精确的选择性、高良品率和易用性。我们的铜、镍、金和银化学镀溶液可在各种材料和催化剂上提供一致的选择性，可在最理想和低成本的模塑复合材料上实现更复杂、更高效的设计。简单且可控的工艺可实现稳定的电镀速率以及长且可预期的槽液性能。

对于当前和不断发展的MID设计的可靠的高良品率，MacDermid Enthone可以实现。



主要特性优点

- 激光直接结构材料的无可比拟的选择性
- 所有现有和新兴塑料的良品率最高
- 稳定、持久、易于使用的化学工艺
- 微间距化镀和引线键合的高技术应用

MacDermid Enthone

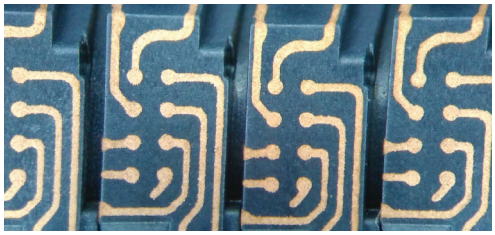
CIRCUITRY SOLUTIONS

MID 选择性金属化

模塑互连装置的解决方案

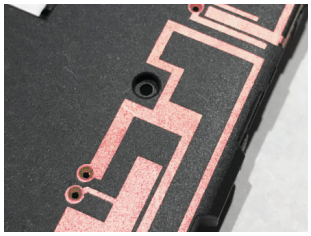
MID SELECTCOAT 200 FL

随着模塑互连器件的应用已从简单的大型天线结构扩展到先进的电子装置，由于激光碎片偏转导致于化学沉积工艺的外部桥接，导体线尺寸已成为问题。MID Selectcoat 200 FL 充当牺牲层完全解决了这个问题，它可以在激光直接结构化后从部件中移除，在LDS迹线之间留下原始表面，从而实现具有更精细几何形状的紧凑设计。



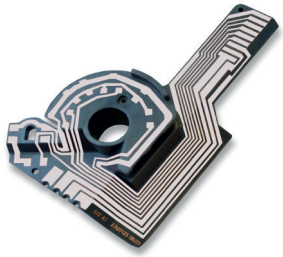
MID COPPER 100

MacDermid Enthone的MID Copper 100工艺为模塑互连器件提供业界领先的化学沉铜金属化。 MID Copper 100是由具有悠久历史的优质化学沉铜工艺开发而来，并由国际药水服务公司提供支持，它是一种化学沉铜工艺，当OEM和供应商有质量和可靠性要求时，由他们指定。所有MID Coppers的配制均可提供卓越的稳定性和性能，从而实现最高的工艺良品率。



ENPLATE LDS NI-200

ENPLATE LDS NI-200是一种中磷化学镀镍沉积，可提供坚固的阻挡层，防止环境腐蚀和电迁移。ENPLATE LDS NI-200是在模塑互连器件上电镀化学沉镍金（ENIG）和化学沉镍/化学沉钯/沉金（ENEPIG）的最佳工艺流程的一部分。这些阻挡层使得可以进行高级装配，包括倒装芯片和金线键合。



ENPLATE LDS AG 600

ENPLATE LDS AG 600是化学沉镍/沉金（ENIG）最终表面处理的替代选项。ENPLATE LDS AG 600是制造商使用的首选沉银工艺，由全球OEM厂商指定。获得专利的银沉积物具有抗锈蚀表面和可靠的焊点连接，可满足所有MID的最终表面处理要求。

MacDermid Alpha ELECTRONICS SOLUTIONS

macdermidalpha.com
January, 2019

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.